

杭州宏华数码科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与合作银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023年04月27日